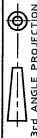
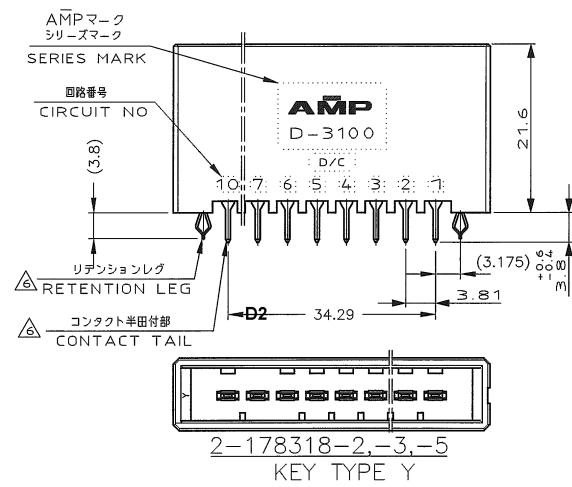
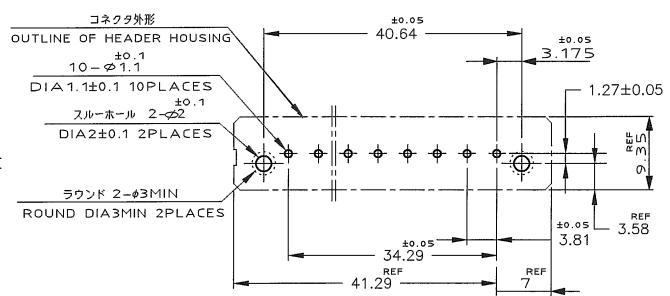
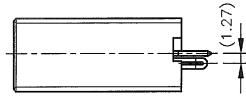
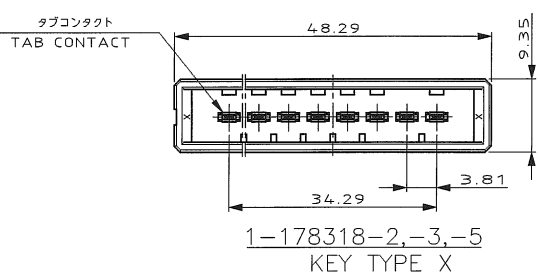


NUMBER 178318



METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL-HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED
- FINISH (CONTACT TAIL): OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リチンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地 膜厚: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地 膜厚: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地 膜厚: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リチンションレグとコンタクト半田付部
- めっき: ニッケル下地の土に半田付部
- めっき: リチンションレグとコンタクト半田付部
- めっき: ニッケル下地の土にスズめっき

Y	△6 △4	2-178318-5	OBSOLETE
	△6 △3	2-178318-3	
X	△6 △2	2-178318-2	
	△6 △3	1-178318-5	
	△6 △2	1-178318-2	
キーイング KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.	

D2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	DATE	DR.	DE.
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.
					Y.TANAKA	Y.TANAKA
					23 JUN 92	22 JUN 92
					S.MANABE	S.MANABE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME
mm (AWG)		mm	10 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100
MATERIAL	SEE NOTE	FINISH	SEE NOTE
GENERAL TOLERANCES		SIZE	LOC
100% ±0.3		A3	J
100% ±0.4		SCALE	REV. D2
100% ±0.5		2-1	SHEET 1 OF 1
100% ±0.5			NUMBER C-178318

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面